

2025年3月期 第2四半期

決算説明資料

上村工業株式会社

東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：4966

2024年11月11日

2025年3月期 第2四半期 決算概要

【連結会計期間】

日本国内(1社)：4月～9月／海外(10社)：1月～6月

● 表面処理用資材事業

- ・ 主力のパッケージ基板向けのめっき薬品の需要は緩やかな回復基調で推移した。また、為替相場の円安による効果も寄与し、売上高、セグメント利益ともに前年同期を上回った。

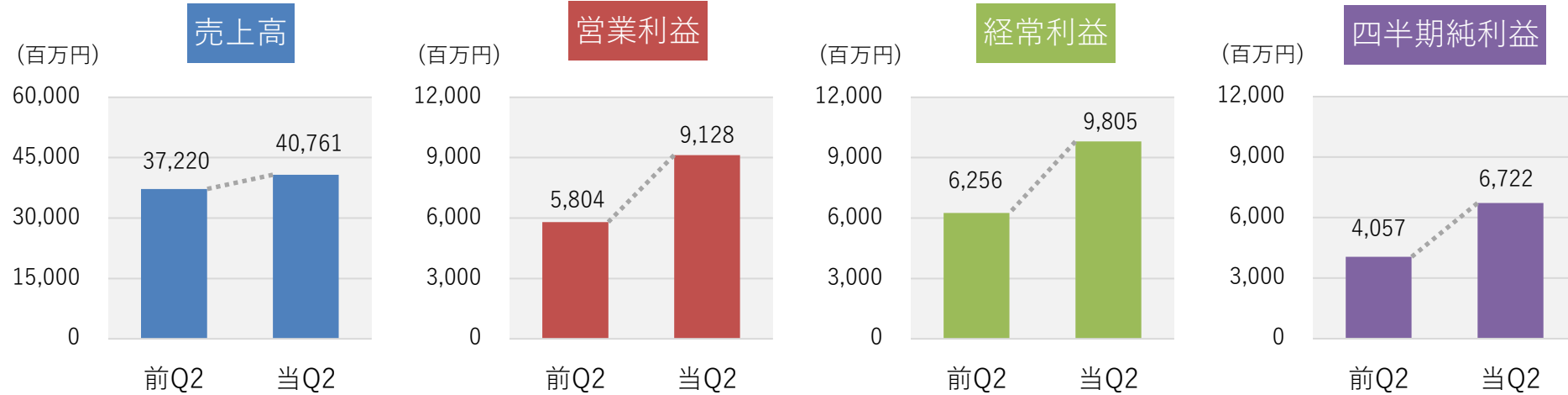
● 表面処理用機械事業

- ・ パッケージ基板メーカーによる新規の設備投資が一巡したことから、売上高、セグメント利益ともに前年同期を下回った。

● めっき加工事業

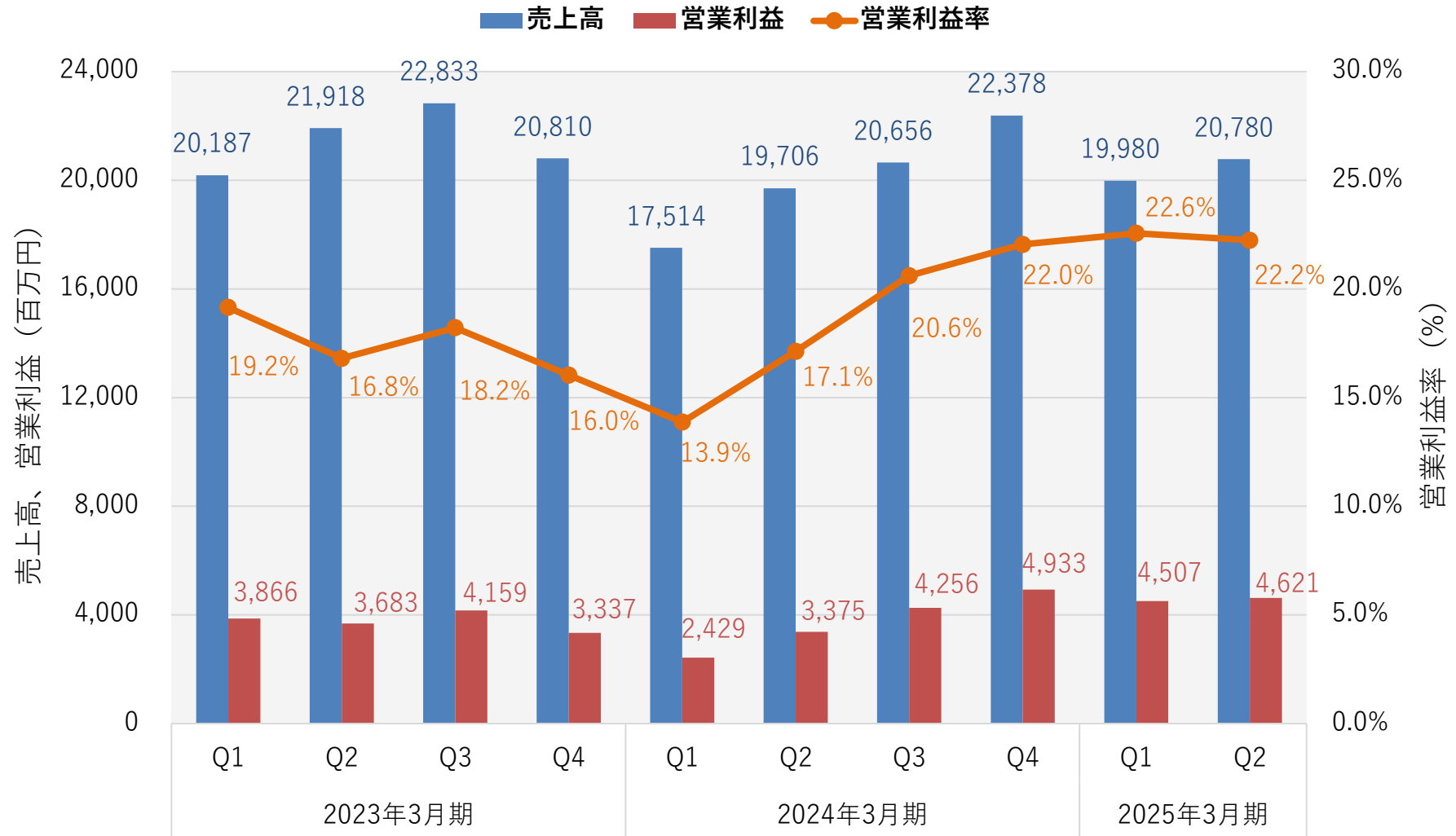
- ・ 自動車部品向けのめっき加工の需要は低調に推移したが、電子回路基板向けのめっき加工の需要が増加し、また、コスト削減や歩留まりの改善に取り組んだことから、売上高は前年同期を上回り、セグメント損失は前年同期より改善した。

2025年3月期 第2四半期 決算概要

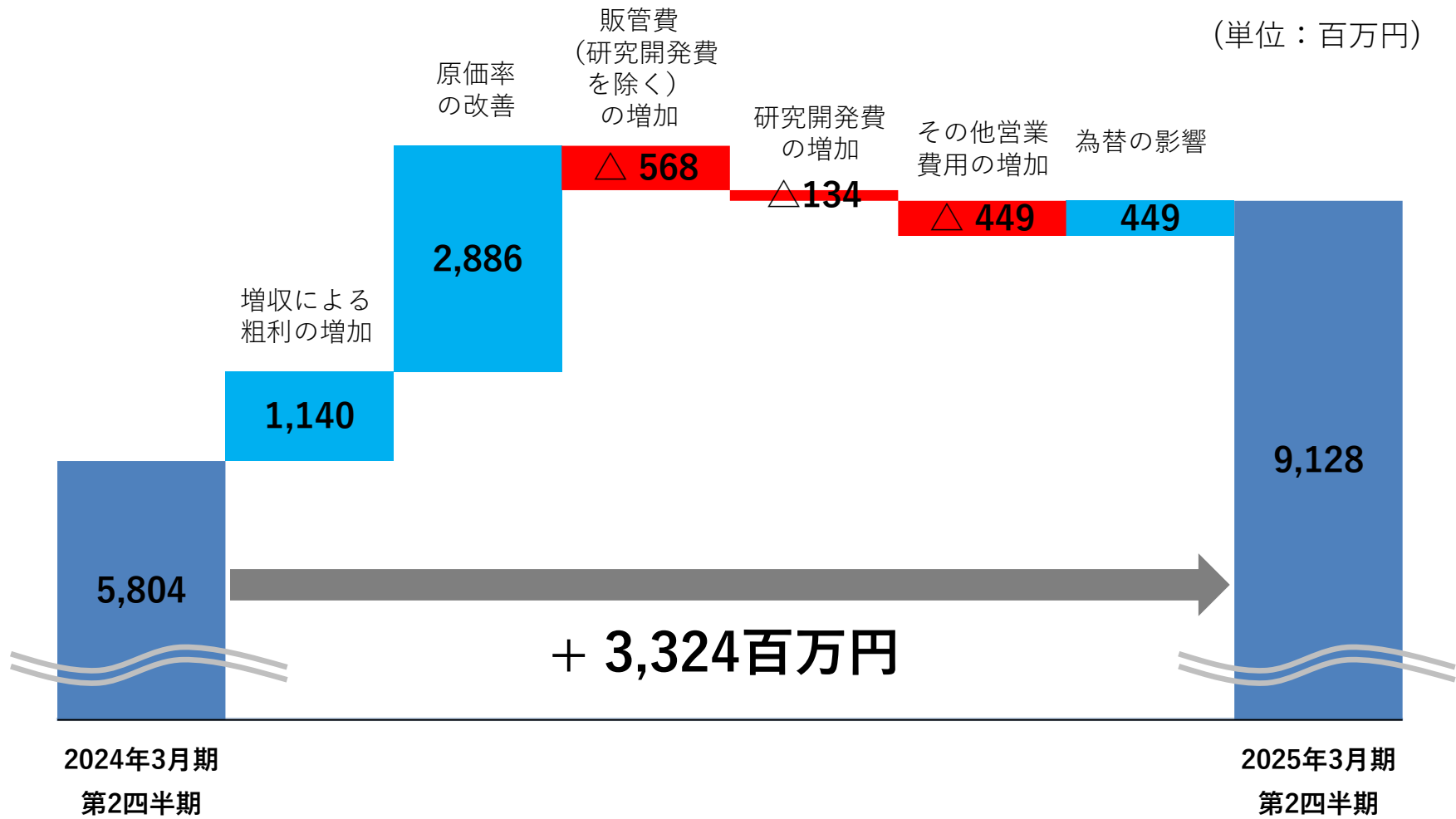


(単位：百万円)	前第2四半期 累計実績	当第2四半期 累計予想	当第2四半期 累計実績	前期比	予想比
売上高	37,220	38,780	40,761	+ 3,541 (+ 9.5%)	+ 1,981 (+ 5.1%)
営業利益	5,804	6,310	9,128	+ 3,324 (+ 57.3%)	+ 2,818 (+ 44.7%)
経常利益	6,256	6,540	9,805	+ 3,549 (+ 56.7%)	+ 3,265 (+ 49.9%)
四半期純利益	4,057	4,960	6,722	+ 2,665 (+ 65.7%)	+ 1,762 (+ 35.5%)
為替：米ドル	135.00円	151.41円	152.36円	17.36円安	0.95円安

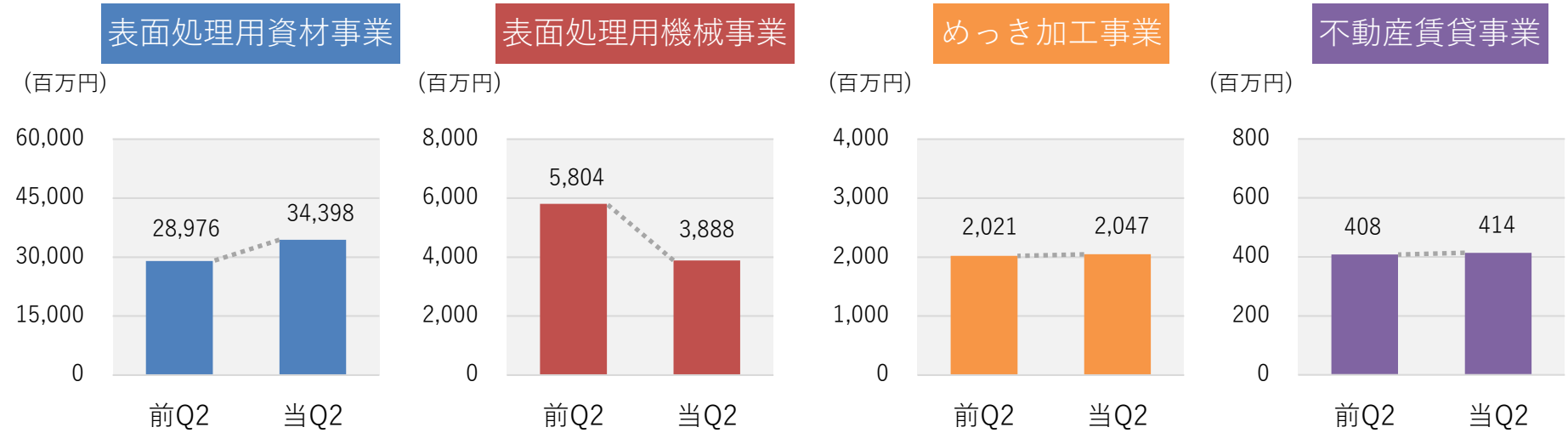
四半期毎の業績推移



営業利益の増減要因

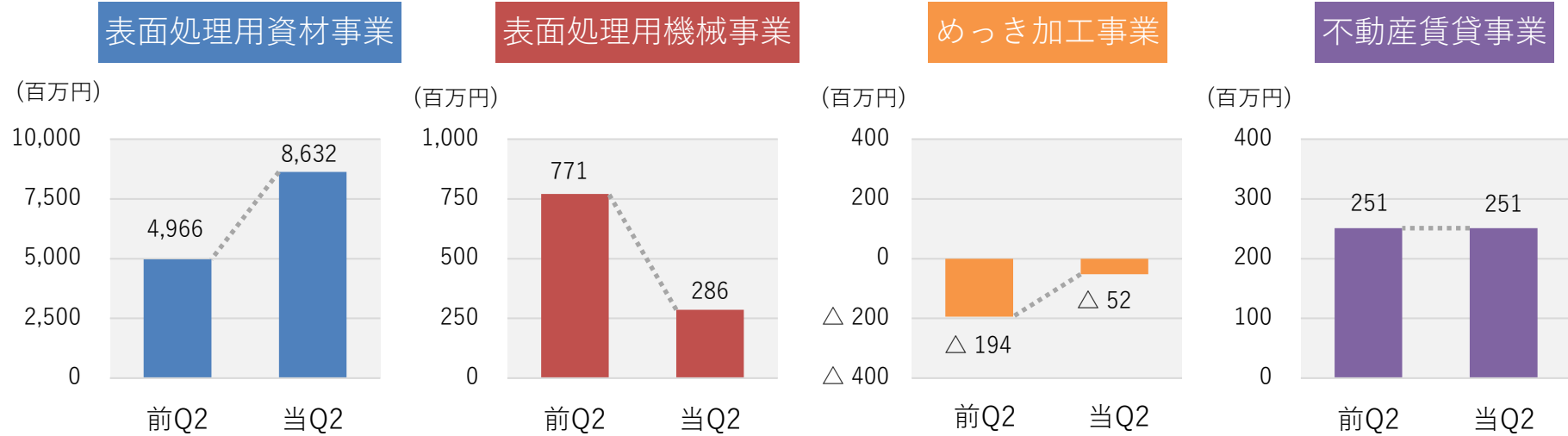


事業セグメント別売上高



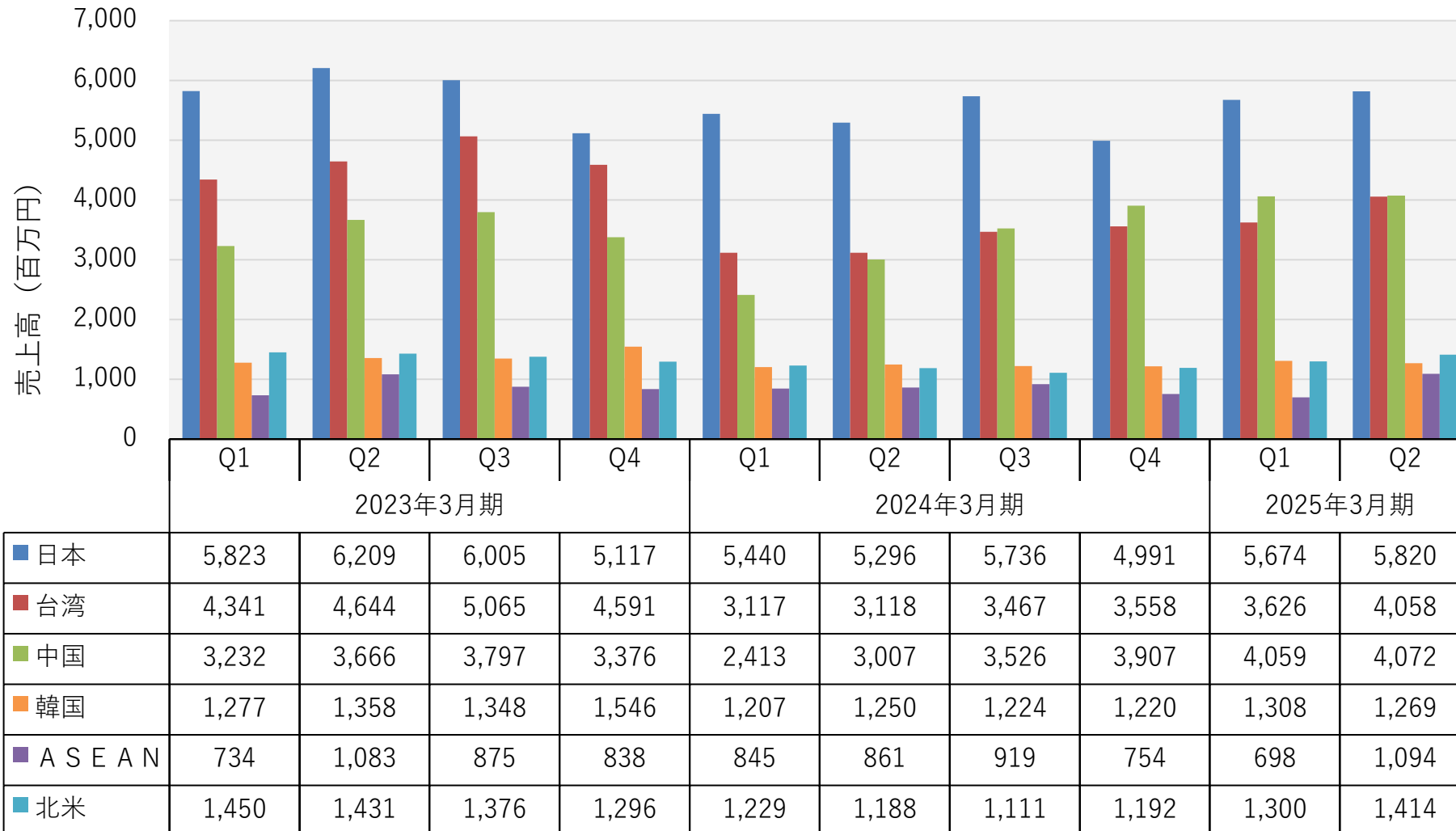
(単位：百万円)	前第2四半期 累計実績	当第2四半期 累計実績	増減額	増減率
表面処理用資材	28,976	34,398	+ 5,421	+ 18.7%
表面処理用機械	5,804	3,888	△ 1,915	△ 33.0%
めっき加工	2,021	2,047	+ 26	+ 1.3%
不動産賃貸	408	414	+ 6	+ 1.5%

事業セグメント別営業利益

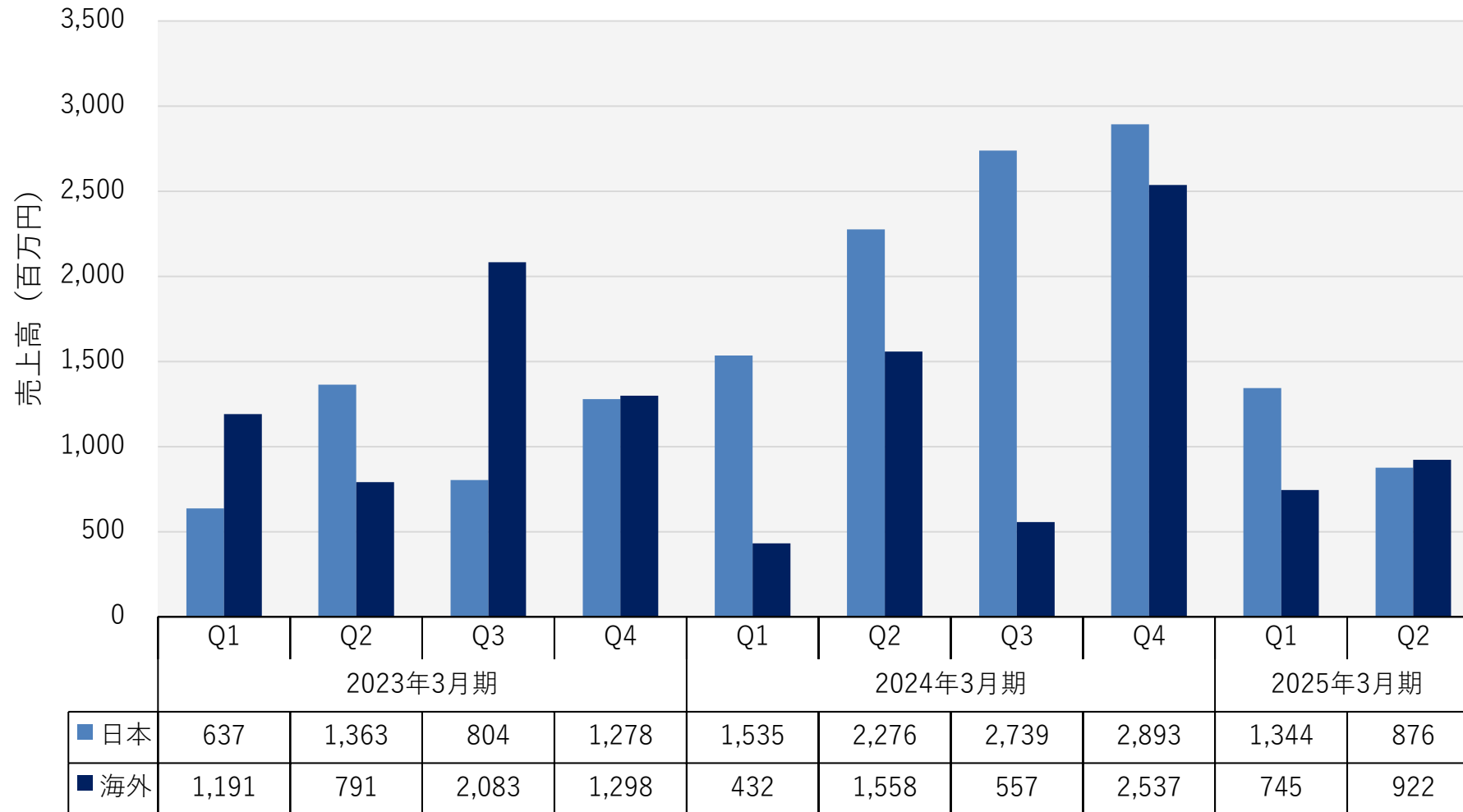


(単位：百万円)	前第2四半期 累計実績	当第2四半期 累計実績	増減額	増減率
表面処理用資材	4,966	8,632	+ 3,665	+ 73.8%
表面処理用機械	771	286	△ 484	△ 62.8%
めっき加工	△ 194	△ 52	+ 141	-
不動産賃貸	251	251	△ 0	△ 0.2%

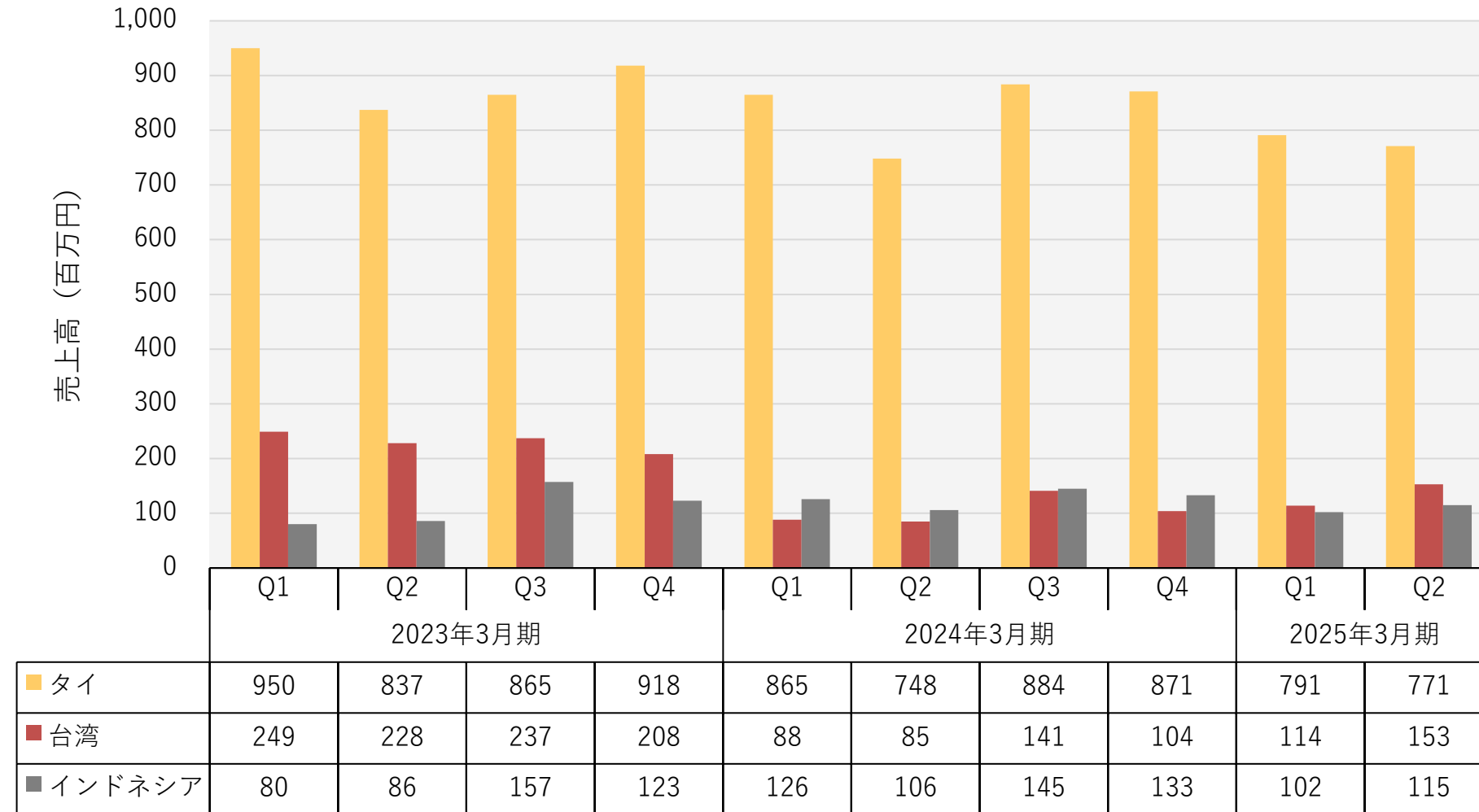
表面处理用資材事業 売上高推移



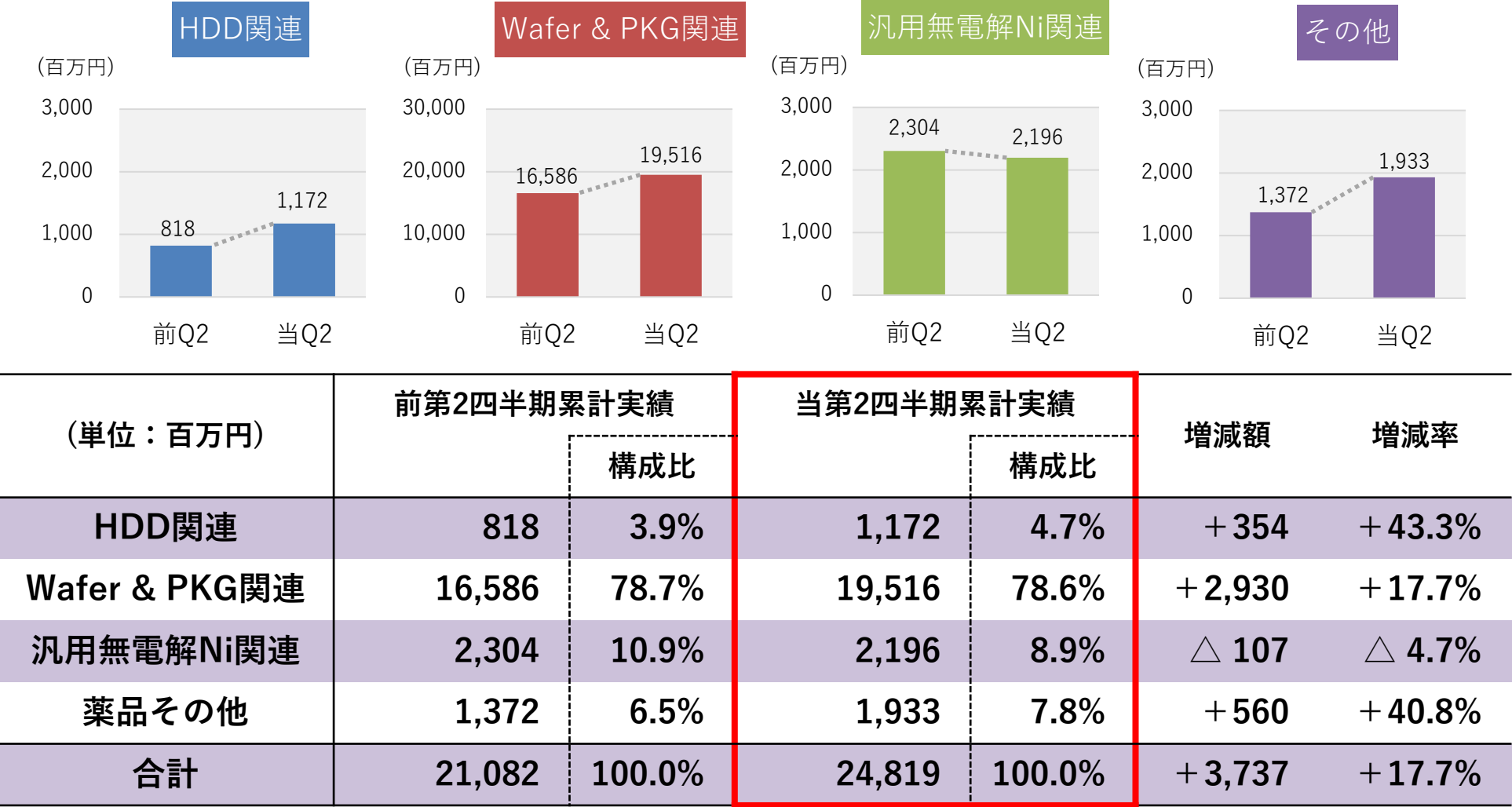
表面処理用機械事業 売上高推移



めっき加工事業 売上高推移



薬品カテゴリー別売上高



薬品の売上高は、表面処理用資材事業に含まれます。薬品には研磨剤、工業薬品、金属等は含んでおりません。※内部売上高含む。

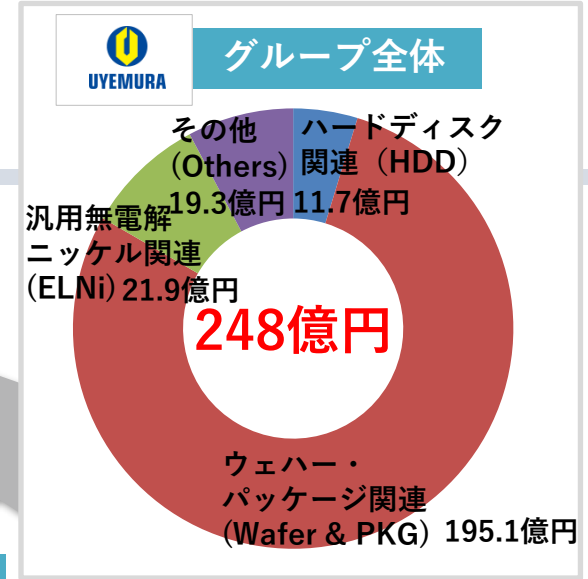
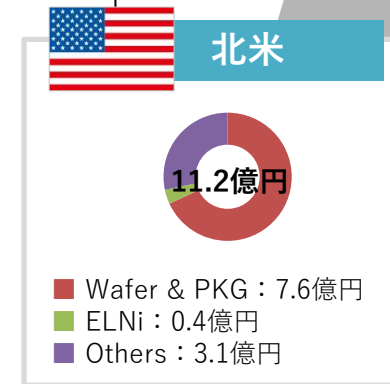
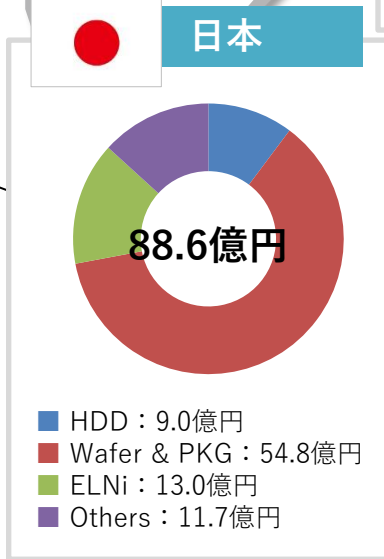
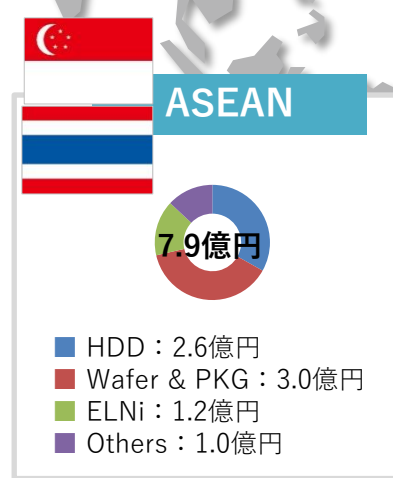
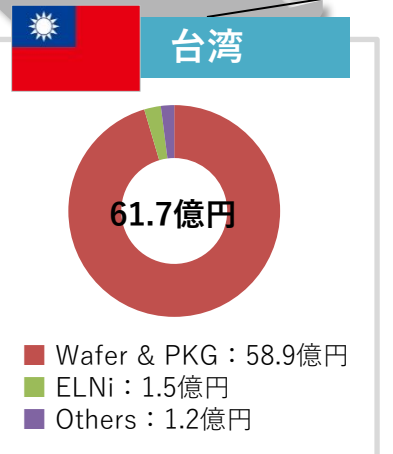
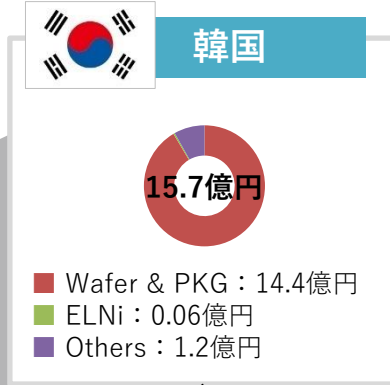
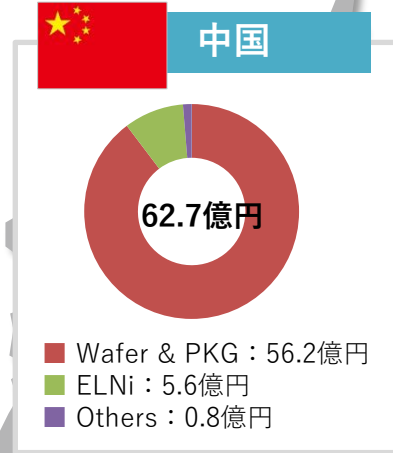
薬品ビジネス 最終製品までの流れ



地域別薬品売上高

2025年3月期 第2四半期累計

※内部売上高含む



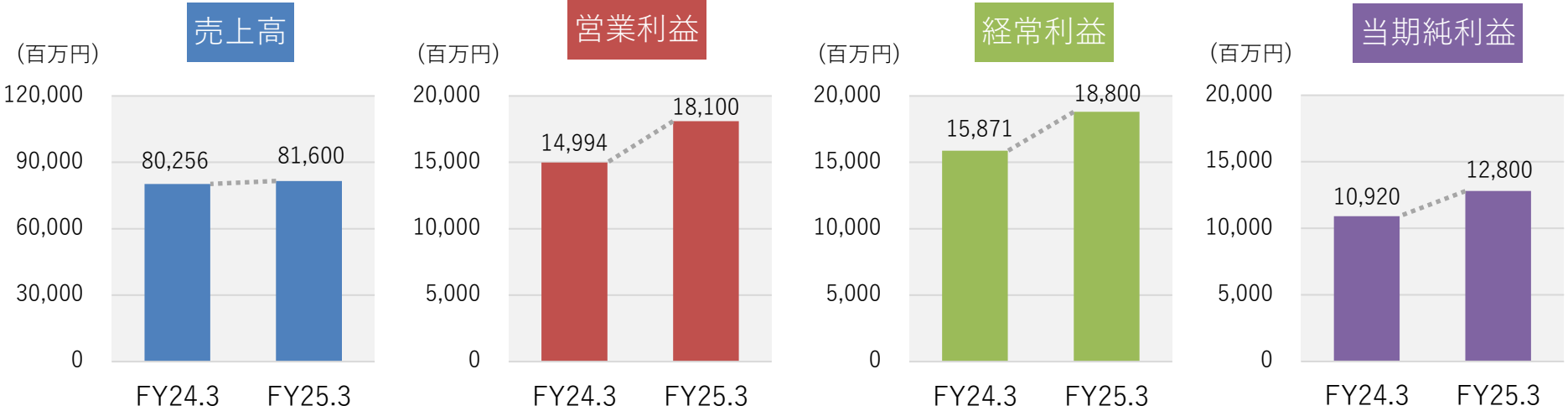
連結業績予想の修正

(単位：百万円)	前回発表予想	今回修正予想	増減額	増減率
売上高	81,150	81,600	+ 450	+ 0.6%
営業利益	13,110	18,100	+4,990	+38.1%
経常利益	13,570	18,800	+5,230	+38.5%
当期純利益	9,720	12,800	+3,080	+31.7%
1株当たり 当期純利益	599.37円	793.73円		

《修正の理由》

人工知能関連市場向けパッケージの増産やデータセンター用サーバー需要の回復に加え、自動車の電動化・自動化に伴う車載用パワーデバイスの需要が堅調に推移したことにより、当社グループの主力製品であるウェハー用およびパッケージ基板用めっき薬品の販売が好調に推移し、売上高、利益ともに前回発表予想を上回る見込みとなった。

2025年3月期 通期業績予想



(単位：百万円)	前期実績	当期予想 (2024.11.11修正)	増減額	増減率
売上高	80,256	81,600	+ 1,344	+ 1.7%
営業利益	14,994	18,100	+ 3,106	+ 20.7%
経常利益	15,871	18,800	+ 2,929	+ 18.5%
当期純利益	10,920	12,800	+ 1,880	+ 17.2%
為替：米ドル	140.67円	151.41円	10.74円安	

2025年3月期 通期業績予想

● 事業セグメント別売上高・営業利益予想

(単位：百万円)	売上高				営業利益			
	前期実績	当期予想 (2024.11.11修正)	当Q2 累計実績	対予想 進捗率	前期実績	当期予想 (2024.11.11修正)	当Q2 累計実績	対予想 進捗率
表面処理用資材	60,583	68,296	34,398	50.4%	12,477	17,480	8,632	49.4%
表面処理用機械	14,528	8,193	3,888	47.5%	2,421	386	286	74.1%
めっき加工	4,298	4,329	2,047	47.3%	△ 346	△ 85	△ 52	-
不動産賃貸	824	815	414	50.8%	422	384	251	65.4%

● 薬品カテゴリー別売上高予想

(単位：百万円)	前期実績	当期予想 (2024.11.11修正)	当Q2 累計実績	対予想 進捗率
HDD関連	1,772	2,600	1,172	45.1%
Wafer & PKG関連	36,153	40,000	19,516	48.8%
汎用無電解Ni関連	4,796	4,400	2,196	49.9%
薬品その他	3,253	3,855	1,933	50.1%
合計	45,975	50,855	24,819	48.8%

<参考> 為替感応度

2025年3月期想定レート：151.41円(JPY/USD)

円安に1円振れると通期で

- ・ 売上：約370百万円増
- ・ 営業利益：約70百万円増

円高に1円振れると通期で

- ・ 売上：約370百万円減
- ・ 営業利益：約70百万円減

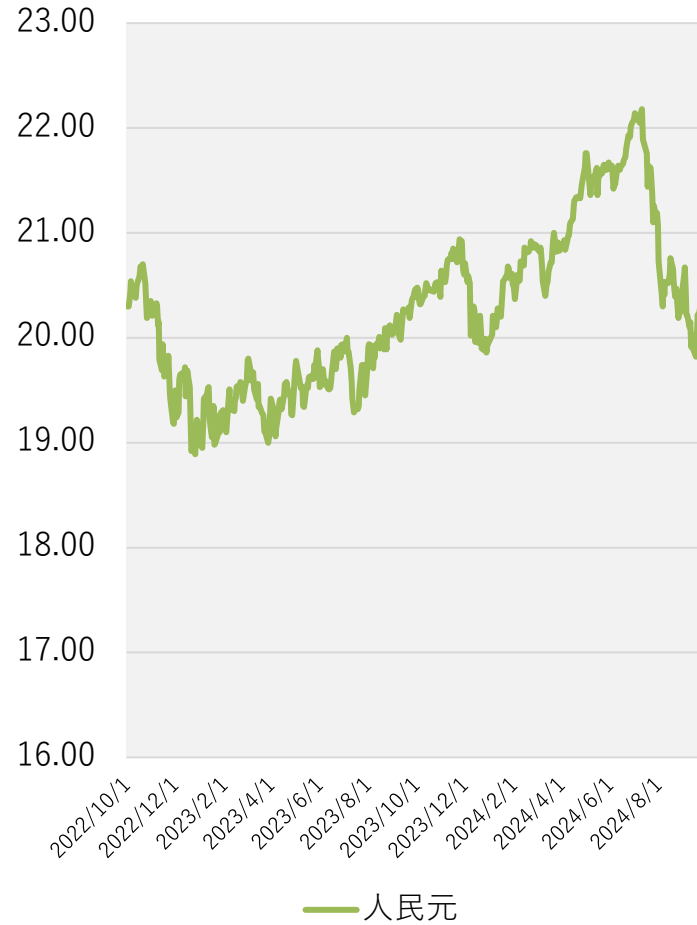
※米ドル以外の通貨も連動して動くことを想定しています。

為替レートの推移

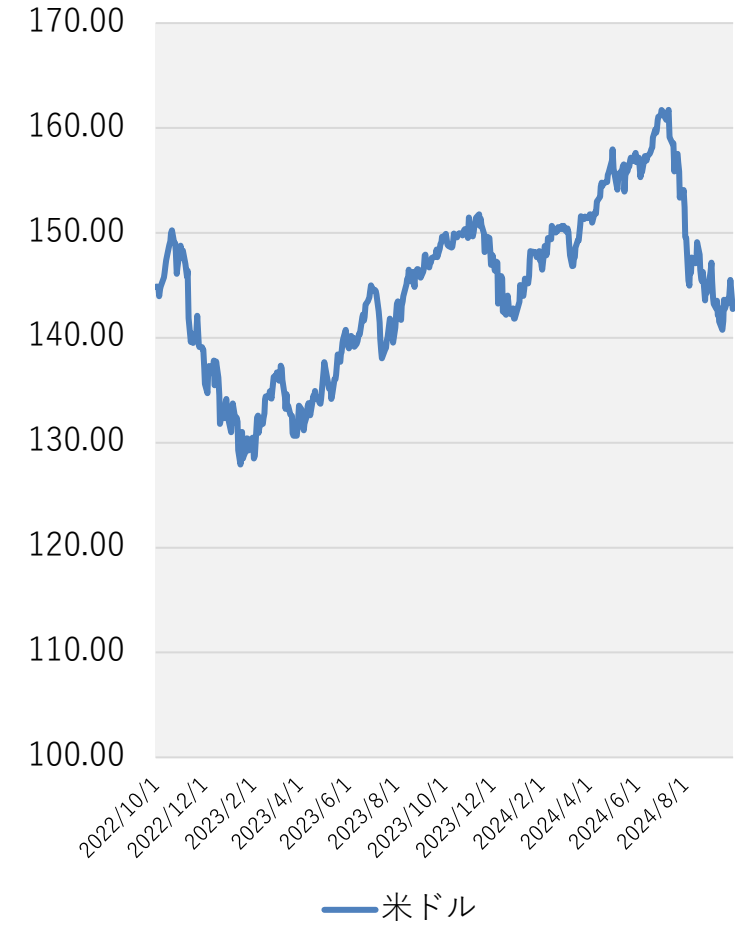
ニュー台湾ドル



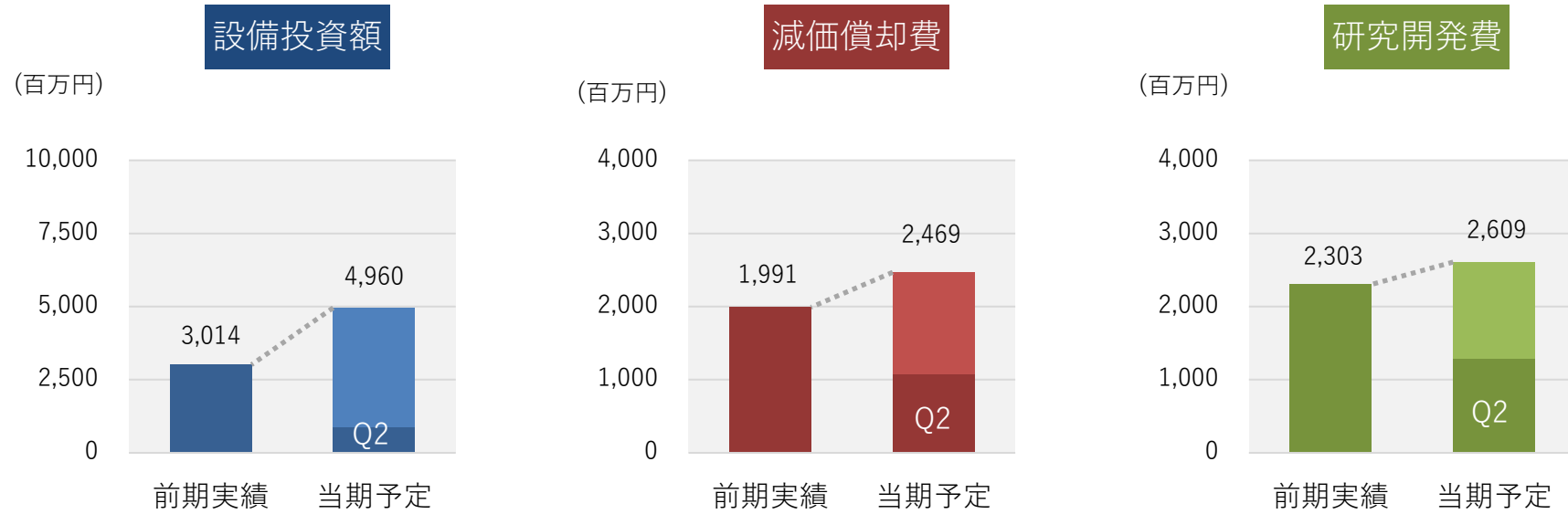
人民元



米ドル



設備投資/減価償却/研究開発費



(単位：百万円)	前期実績 (通期)	当第2四半期 累計実績	当期予定 (通期)
設備投資額	3,014	900	4,960
減価償却費	1,991	1,074	2,469
研究開発費	2,303	1,288	2,609

配当政策

安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針とした配当政策に取り組んでいます

1株当たり配当金
200円以上
を維持

- 配当の下限值設定による安定した配当の実現
- 企業価値向上につながる研究開発設備の充実や半導体分野への投資の拡充

<トピックス> 枚方工場再構築の進捗状況

化成品工場（大阪府枚方市）の増設を計画

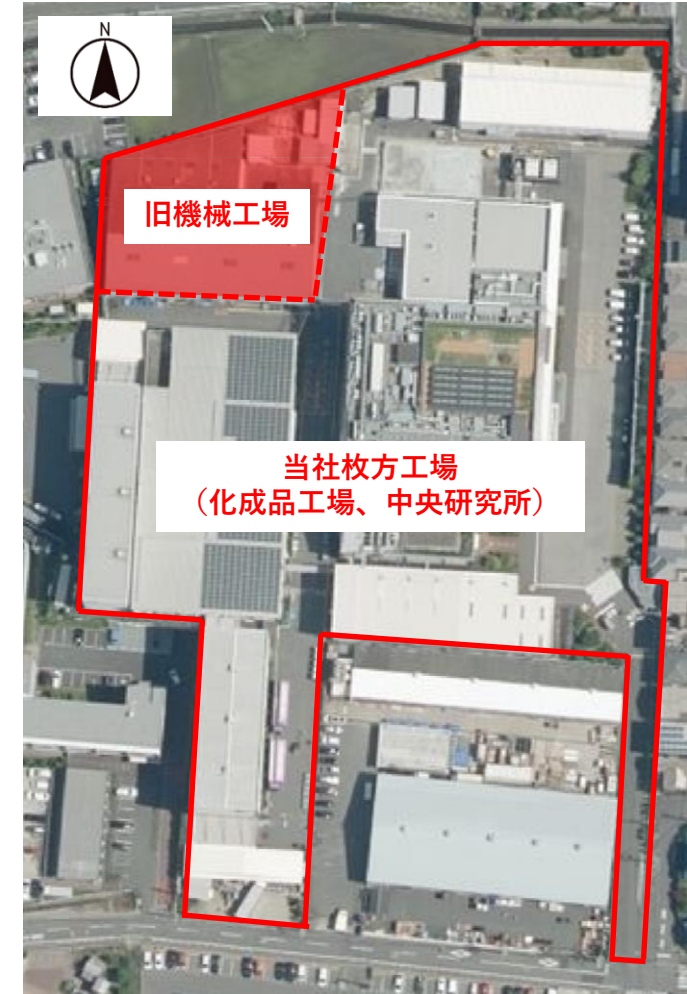
当社の枚方工場敷地内に立地していた機械工場は、2023年11月に近隣地へ移転いたしました。今後、旧機械工場区画の建屋を解体し、新たに化成品工場を増設することにより、半導体分野の需要増加に備えた薬品生産能力の拡張に取り組んでまいります。

増設化成品工場の計画概要

- ・ 鉄骨造り、地上3階建
- ・ 建築面積：1,450m²（延べ面積：3,500m²）
- ・ 投資予定金額：約21億円
- ・ 完成予定時期：2027年12月末

今後の計画

- ・ 管理棟解体、第3研究棟新築
- ・ 既存化成品工場の再整備
- ・ 製品倉庫の改造



国土地理院撮影の空中写真を加工して作成

<トピックス> 韓国子会社における設備投資

生産効率・品質向上に向けた取り組みを推進

当社の韓国連結子会社（韓国上村株式会社）は、2011年の工場設立から約13年が経過し、生産効率の向上と品質の安定を図るため、製造設備の改造、実験室の環境改善、自動化の推進、次世代装置の導入などを進め、顧客ニーズへの対応とコスト削減に取り組んでおります。

主な投資内容（2025年3月期）

- 製造設備の改造（強アルカリ製品の品質安定化）
- 実験室の環境改善（老朽化した設備の更新と実験スペースの確保）
- IBC/DRUM 自動充填設備導入（充填作業の自動化）
- 垂直搬送連続めっき装置の設置（顧客への技術支援強化）

投資金額（2025年3月期）

約25億ウォン（約2.8億円）

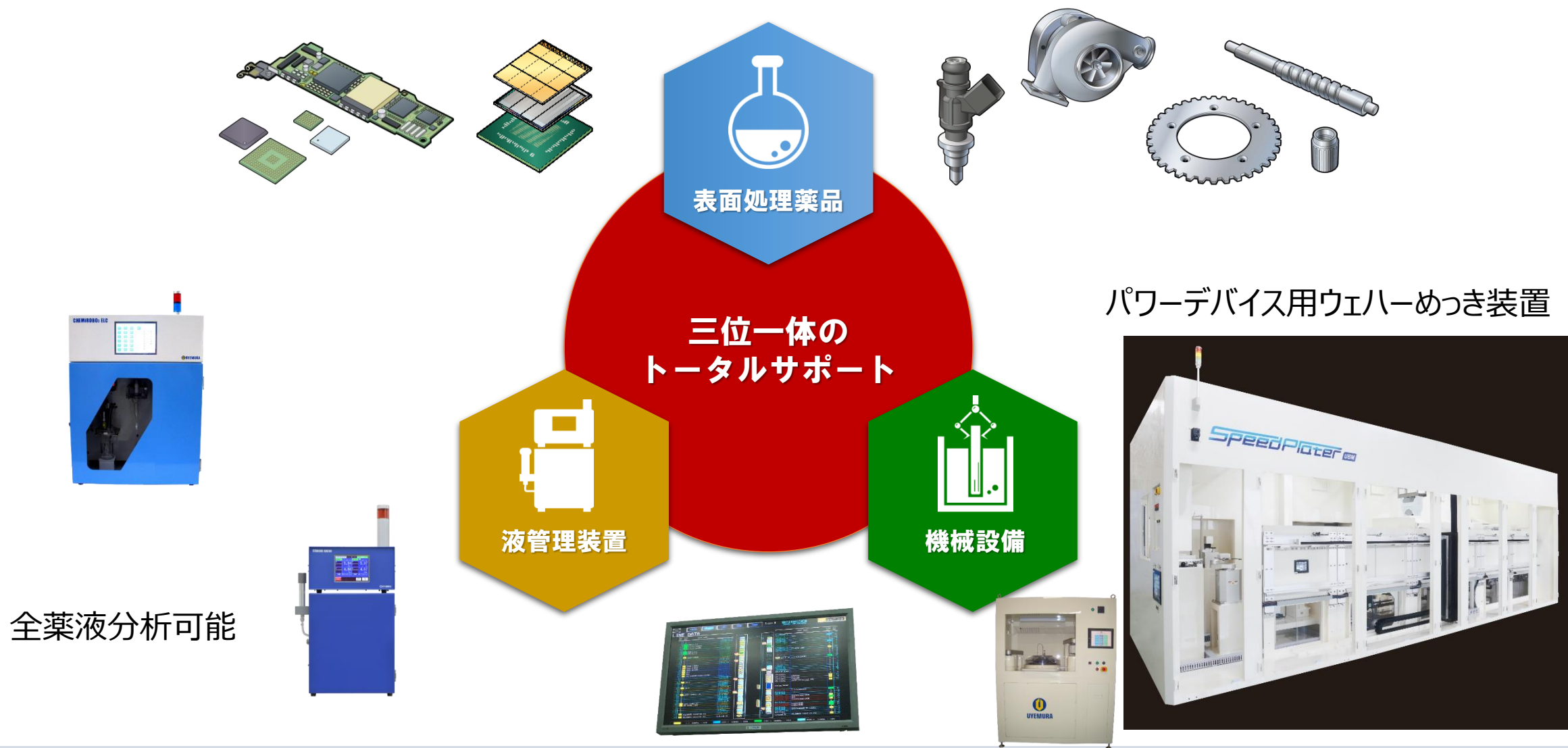
韓国上村株式会社（京畿道華城市）



主要ビジネス状況

顧客満足度向上を目指す 誠心を以って実行に徹底する

- 市場占有率が高い市場では、更に市場占有率を高めるための営業および開発戦略
- 市場占有率が低い市場では、市場占有率を上げるための営業および開発戦略
- 市場の流れに合う製造戦略
- 薬品、機械および液管理装置のトータルソリューションの提供



➤ 現行市場状況

① 国内：PC関連、通信、パワーデバイスは好調。ハードディスクは回復傾向

サーバー関連はエンドユーザーのターゲット分野によって差があるが徐々に回復傾向

② 海外：国内とほぼ同じ傾向。車載も同様

➤ 現在注力している技術

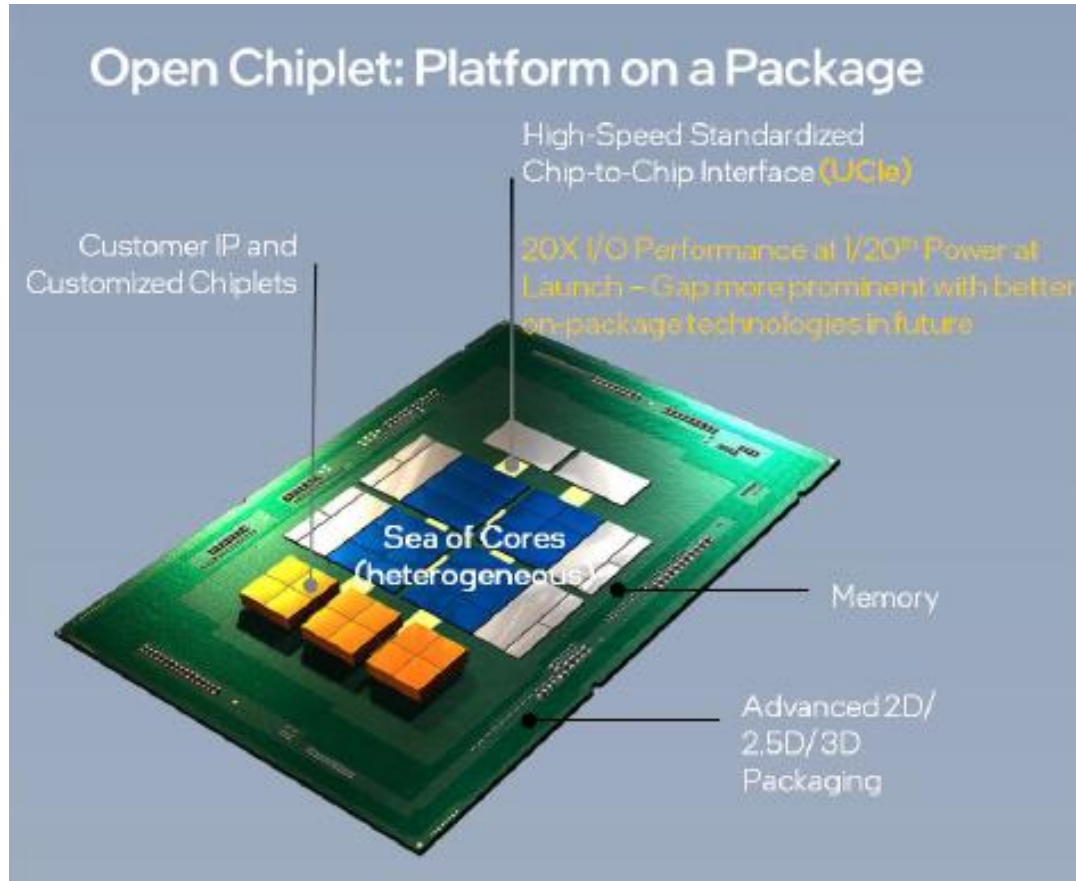
次世代パッケージ技術、通信向け基板技術、カーエレクトロニクス技術、環境関連技術

➤ 今後注力すべき技術

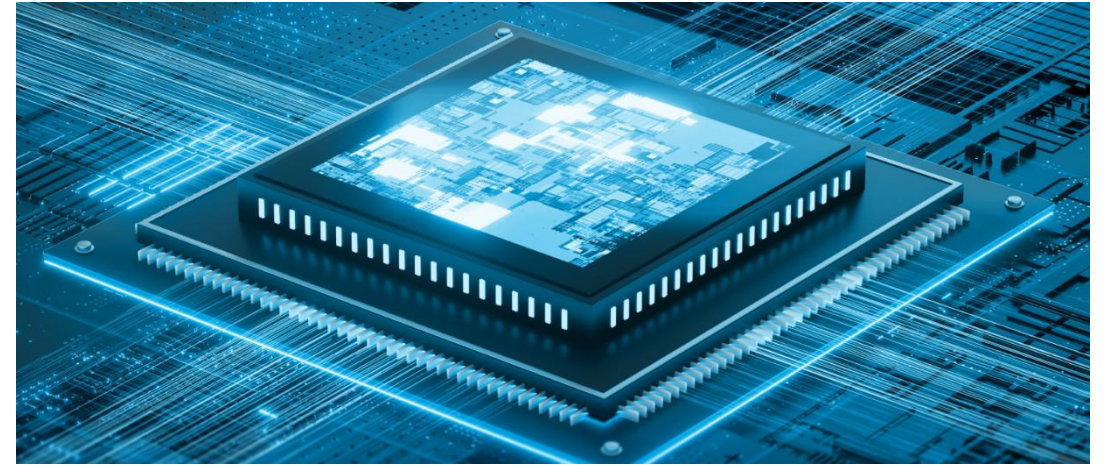
先端パッケージ向け配線技術および bumps 接合技術

次世代接合材料向け表面処理技術、環境対応トータル技術開発

先端パッケージに求められる技術



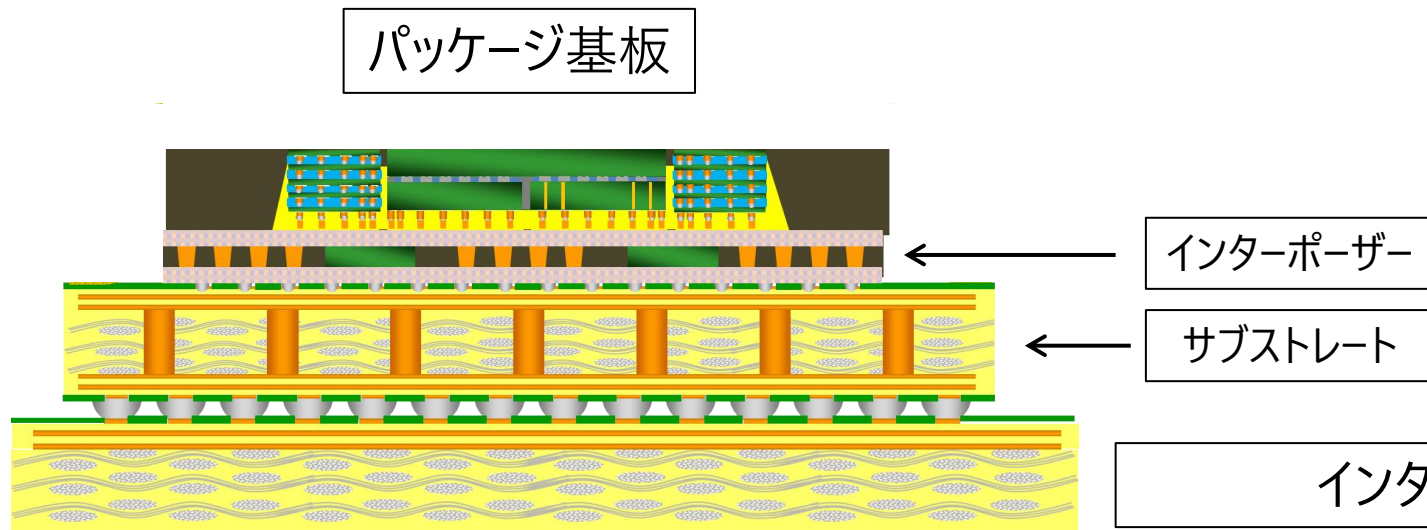
Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe): Building an open ecosystem, UCIe, March 2022



ASRA(Advanced SoC Research for Automotive):
自動車用先端SoC技術研究組合ホームページ, asra.jp

- 1) 高信頼性基材の導入
- 2) 高信頼性接合技術の進歩
- 3) 消費電力削減への挑戦

先端パッケージへのガラスコア適用可能性



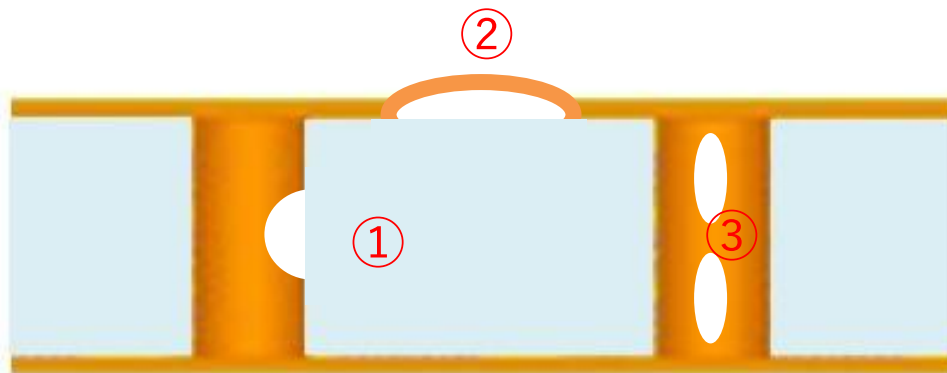
ガラス特性

- 高剛性
- 低熱膨張係数
- 高平滑性

要求特性

- ⇒ ねじれ寸法精度
- ⇒ 反り寸法精度
- ⇒ 微細配線形成

インターポザーやサブストレートにガラス採用



スルホール付きガラス基板

懸念事項

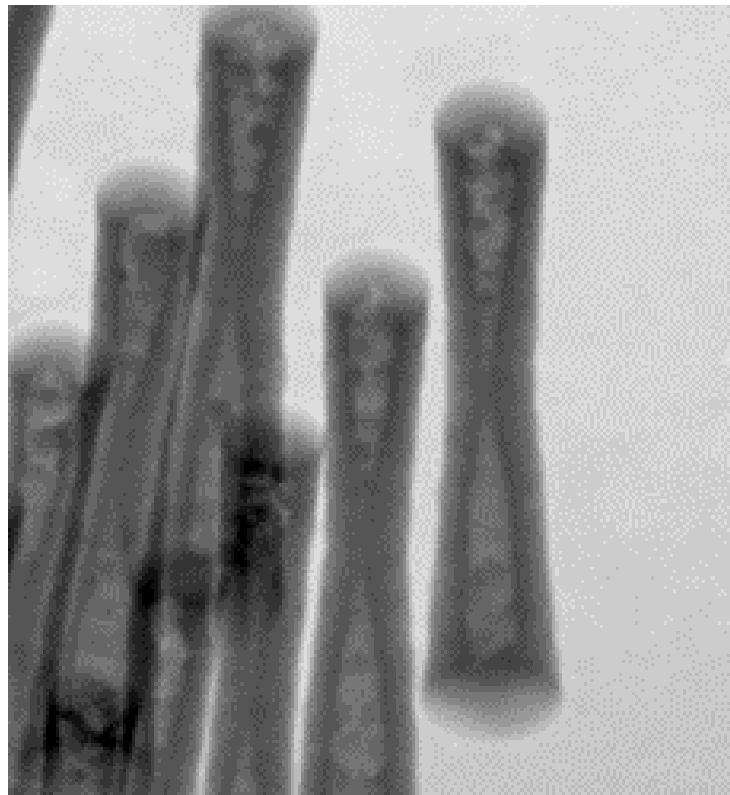
- ① スルホール内断線
- ② 配線密着性
- ③ TH内部の埋め込み性

ガラスコア向けシード層及びTH filling電解Cuの提案

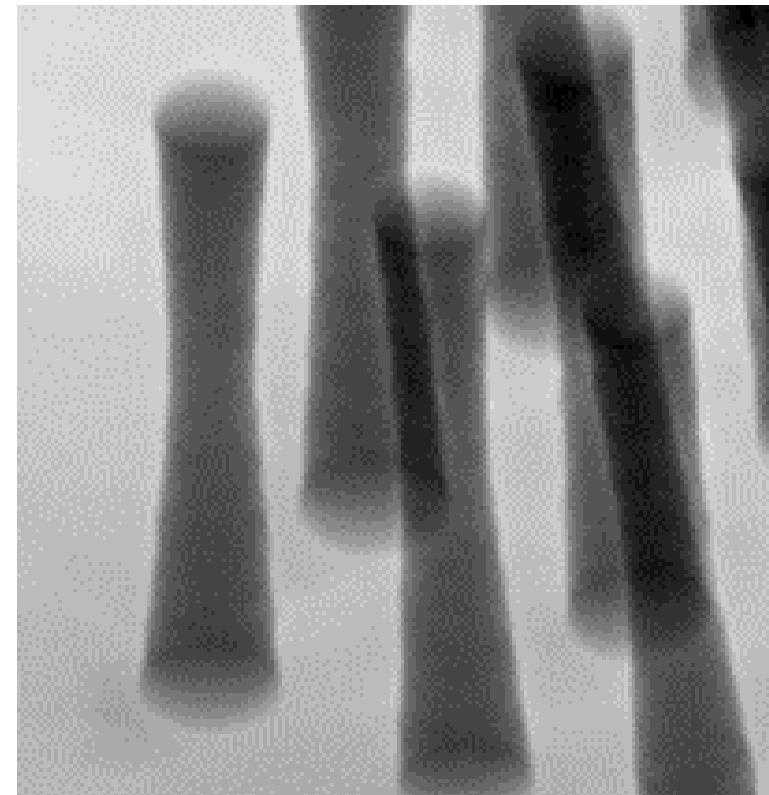
MOSL
(Metal Oxide Seed Layer)

Electroless Cu
(Seed for Electrolytic Cu)

Electrolytic Cu
(TH Filling)



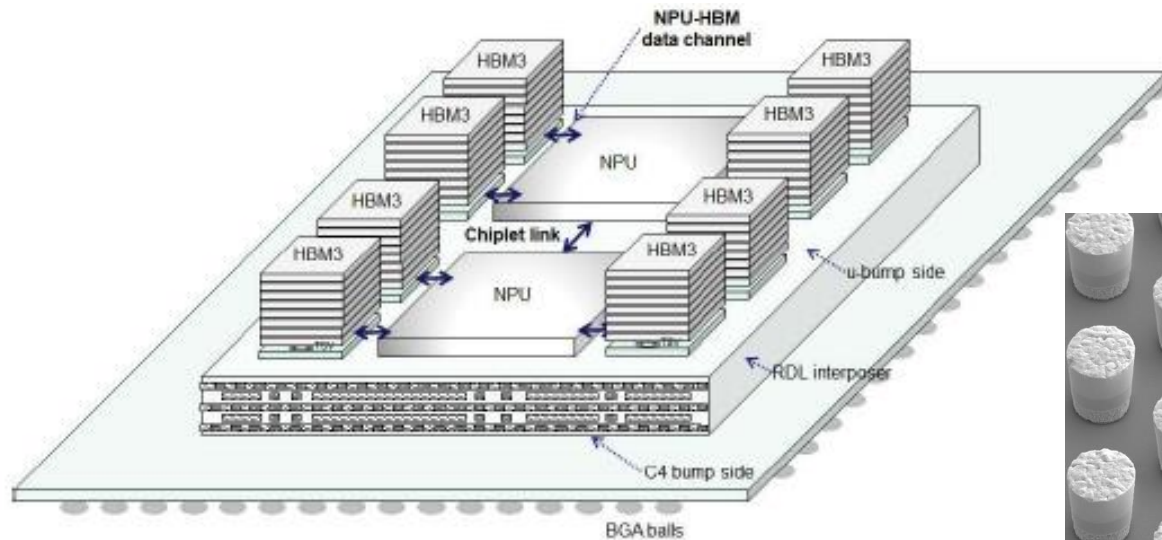
Old electrolytic Cu



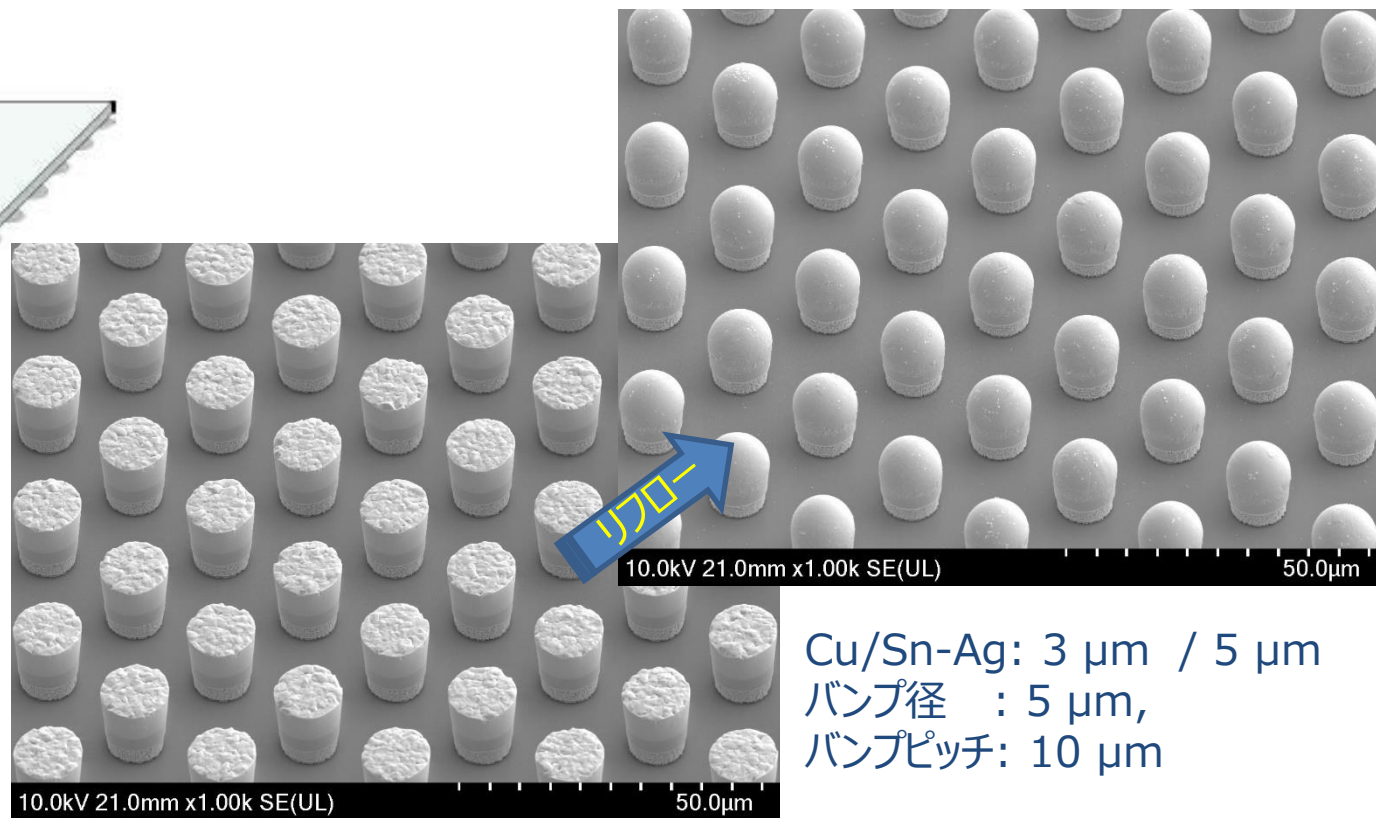
New electrolytic Cu

TGV opening diameter	100 μm
TGV center diameter	70 μm
Board thickness	600 μm

先進パッケージ向け bumps 形成技術の提案



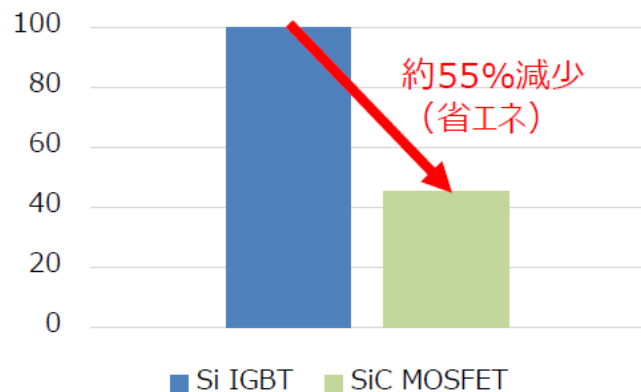
Chiplet Heterogeneous-Integration AI Processor,
International conference on Electronics, Information
and Communication (ICEIC), February 2023



国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
「ポスト 5 G 情報通信システム基盤強化研究 開発事業」(JPNP20017)

次世代パワー半導体に求められる技術

<Si/SiCパワー半導体のエネルギー損失>

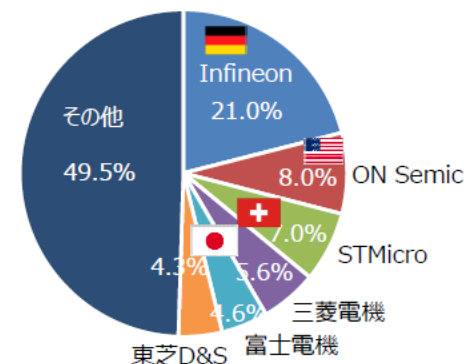


※用途は、鉄道車両用インバーターを想定
 ※縦軸（エネルギー損失）は、Siパワー半導体を100とした場合の値

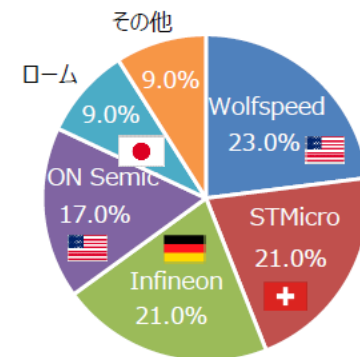
SiCパワー半導体の市場推移



Siパワー半導体のシェア



SiCパワー半導体のシェア



半導体・デジタル産業戦略の現状と今後, 経済産業省, 令和5年11月29日

< SiCの特性 >

- 1) 電力損失の低減
- 2) 高い動作温度
- 3) 高速スイッチング動作
- 4) 高い放熱効果

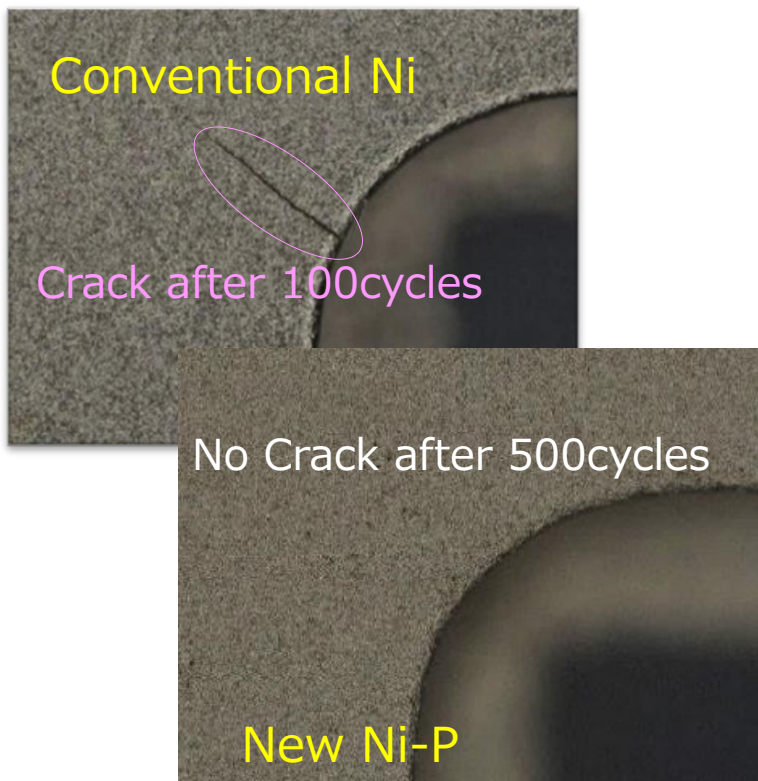
高い動作温度へ適応した材料

→ 焼結材料、封止材料、表面処理、等

新規接合材料（銀焼結、銅焼結、銅ワイヤ）へ適したプロセスの提案

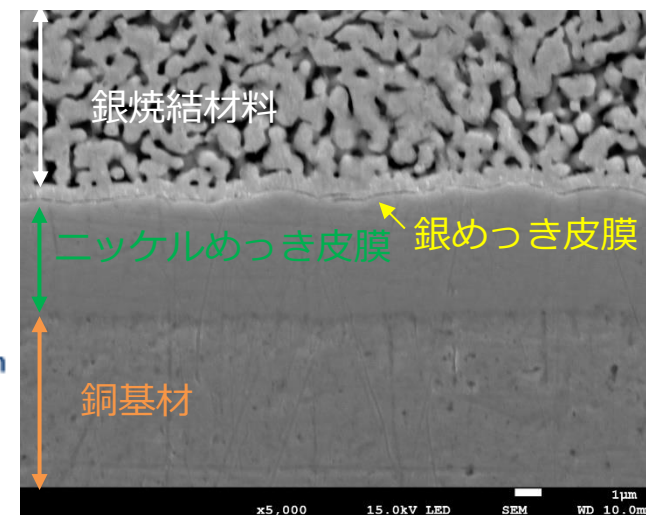
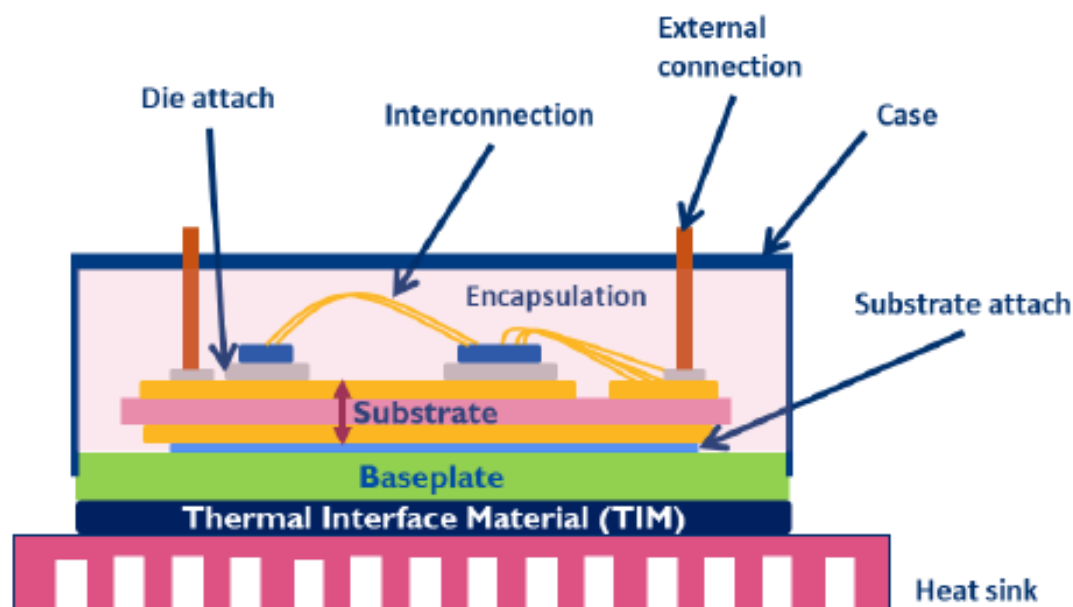
耐熱クラック性に優れた
Ni-P皮膜形成

After TCT(-50℃ $\rightleftharpoons$ 250℃)



銅焼結、銅ワイヤとの接合性に
優れたAl上ダイレクト無電解Cu

「銀」焼結材料への接合性
に優れた「銀」皮膜形成



Status of the Power Module Packaging Industry 2021-Market and Technology Report, Yole development, November 2021

ESG・SDGsに関する取り組み

当社は「Growing together with  (UY:You)」のグループ共通スローガンのもと、ステークホルダーの皆様と共に成長・発展し、社会に貢献できる企業を目指しています

Environment（環境）

環境対応型製品・技術の開発・拡販



社会発展・環境改善へとつながる製品の開発・提供



廃棄物・水使用量の削減



クリーンエネルギーの使用、電力使用量の削減



持続可能な
社会の実現

Social（社会）

社会貢献・地域貢献活動の推進



受注から出荷までの工程の自動化

いきいきと働ける職場環境の整備



Governance（ガバナンス）

コンプライアンスの徹底、人権の尊重



BCP（事業継続計画）の実施



詳細な取り組み内容については、当社ホームページをご確認ください



1. Pbフリーめっき浴

- ・無電解Niめっき浴。主に汎用浴向け。
- ・Pbフリーの電気Snめっき浴。純Sn、Sn-Ag浴など。電子部品向け。

2. シアンフリー浴

- ・シアンフリー & フリーシアン補給不要の無電解Auめっき浴。ウェハー、電子部品向け。

3. デスミアフリープロセス

- ・危険な過マンガン酸をつかわない基板向けプロセス。

4. ホルマリンフリー浴およびホルマリン不使用プロセス

- ・ホルマリンフリー無電解Cu浴の開発。ウェハー向け。

5. PFOS, PFOA, PFASフリー浴

- ・PTFE複合めっき。主に車載部品向け。

6. 廃液処理

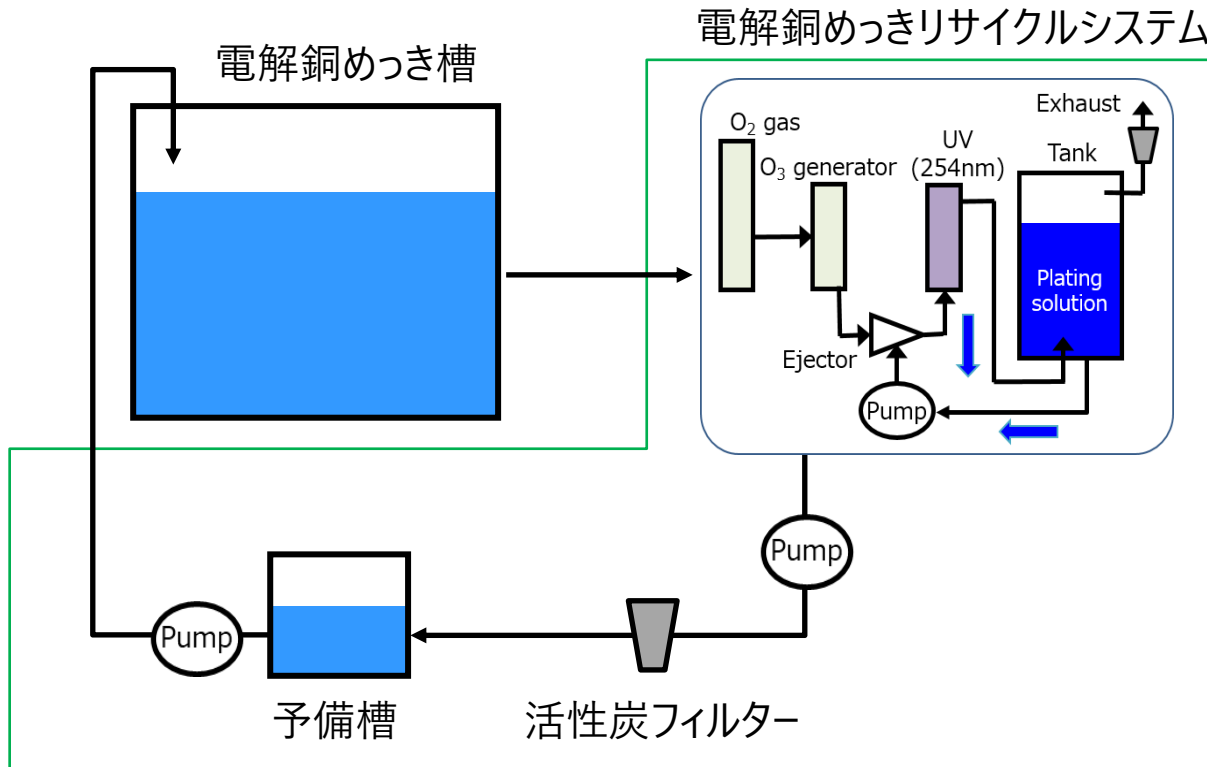
- ・めっき液リサイクルユニット

7. CO₂削減

- ・低融点接合材料めっき、低融点接合に適した最終表面処理



電解銅めっき リサイクルシステムイメージ



< 従来 >

電解銅めっき液は老廃物蓄積に伴い、一定期間使用後に全量廃液

< 新規提案 >

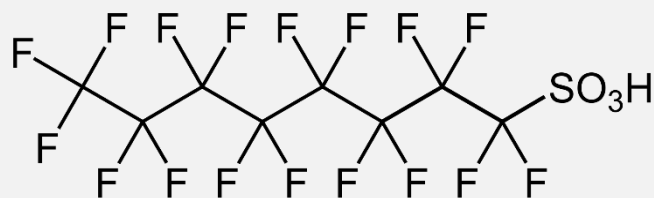
めっき液の一部を再生システムによって老廃物を分解除去することで、めっき液全体の性能を一定に保持

→ 半永久的なめっき液寿命

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals)

PFAS : Per- and PolyFluoroAlkyl Substances

PFOS : perfluorooctanesulfonic acid



2019~ PFOA free type

NIMUFLON, NIMUFLON FUL (Type JB)

2024~ PFAS free type

NIMUFLON FUL (FPR-1)
(under development)

2011~ PFOS free type

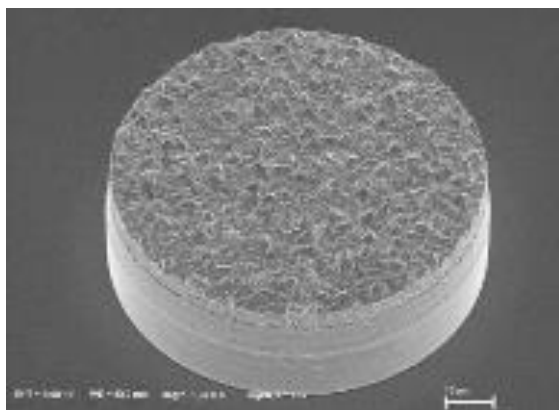
NIMUFLON, NIMUFLON FUL (Type B)

PFOA : perfluorooctanoic acid

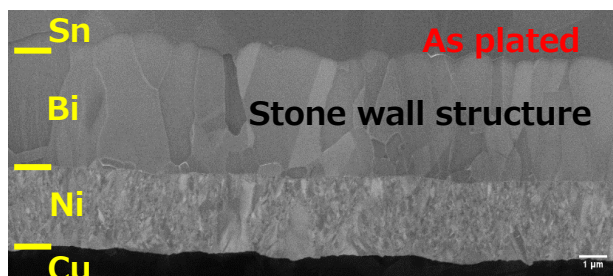


低融点 → 省電力 → CO₂削減

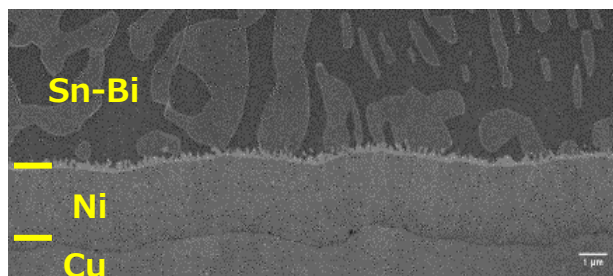
1) 低融点はんだ材料のバンプめっき



Sn surface
(Cu/Ni/Bi/Sn)

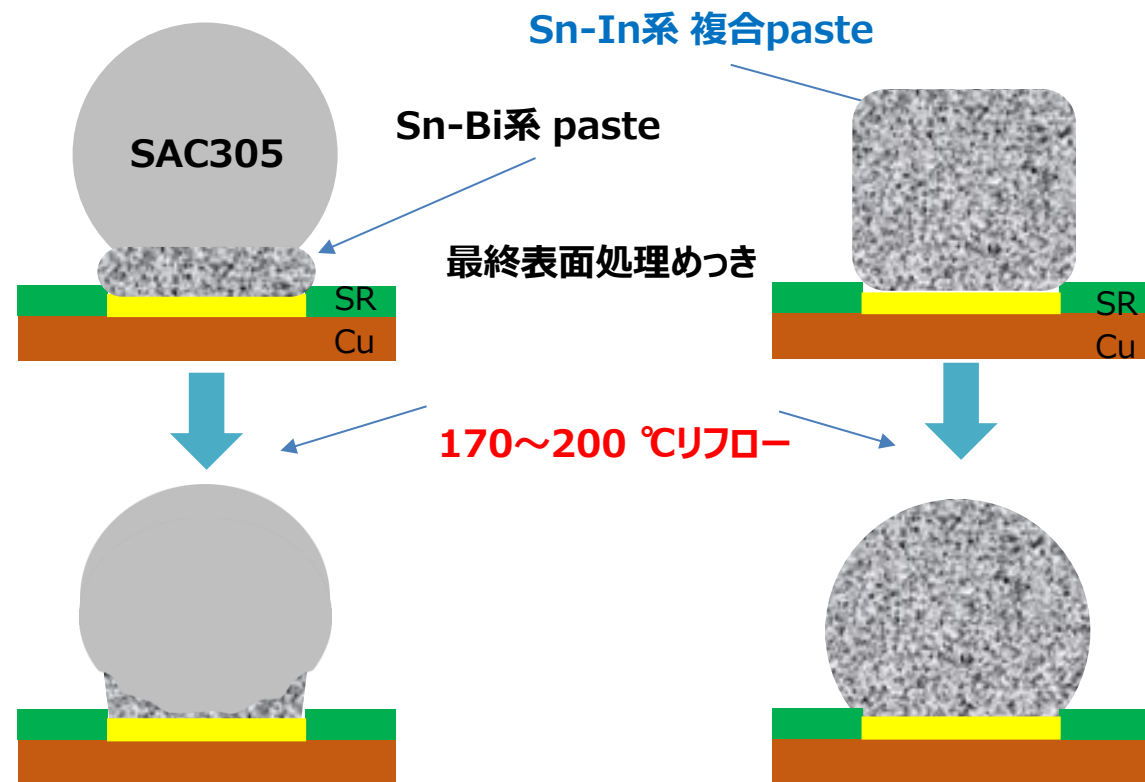


150 °Cリフロー



Solder/solder joint for low temperature reflow by multi plating method, Wafer-level Packaging Symposium, January 2023

2) 低融点はんだ材料に適した最終表面処理の検討



グループ会社一覧

会社名	設立年	所在地	主な事業内容
上村工業株式会社	1848年(創業) 1933年(設立)	日本	    
ウエムラ・インターナショナル・コーポレーション	1985年	米国	  
上村(香港)有限公司	1986年	中国 (香港)	
台湾上村股份有限公司	1987年	台湾	    
サムハイテックス	1987年	タイ	   
上村工業(深圳)有限公司	1988年	中国 (深圳)	   
ウエムラ・インターナショナル・シンガポール	1992年	シンガポール	
ウエムラ・マレーシア	1996年	マレーシア	 
上村化学(上海)有限公司	2002年	中国 (上海)	
韓国上村株式会社	2010年	韓国	 
ウエムラ・インドネシア	2012年	インドネシア	 



営業



研究開発



薬品製造



機械製造



めっき加工



不動産賃貸

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

Growing together with



Uyemura Group Companies

● Japan	C.Uyemura & Co., Ltd.	● Taiwan	Taiwan Uyemura Co., Ltd.
● USA	Uyemura International Corporation	● Korea	Uyemura Korea Co., Ltd.
● Hong Kong	Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd.	● Singapore	Uyemura International (Singapore) Pte Ltd
● Shenzhen	Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd.	● Malaysia	Uyemura (Malaysia) Sdn. Bhd.
● Shanghai	Uyemura (Shanghai) Co., Ltd.	● Thailand	Sum Hitechs Co., Ltd.
		● Indonesia	PT. Uyemura Indonesia